

112學年度日間部電子工程系-封裝測試產業精英專班二專課程規劃表

第一學年(112)					第二學年(113)						
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
校 必 修	微積分(一)(二)	3	3	3	3	校 必 修					
	體育	1	2	1	2						
	中文閱讀與表達(一)(二)	2	2	2	2						
	程式設計概論	3	3								
	人工智慧概論與應用			3	3						
	小計	9	10	9	10		小計				
院 必 修	化學與化學實驗(一)(二)	3	3	3	3	院 必 修					
	物理與物理實驗(一)(二)	3	3	3	3						
	小計	6	6	6	6		小計				
專 業 必 修	科技英文(一)(二)	2	2	2	2	專 業 必 修	奈米科技概論	3	3		
	數位邏輯設計			3	3		電子學與電子實習(二)	3	3		
	電子學與電子實習(一)			3	3		積體電路封裝專論	3	3		
	電路學	3	3				積體電路測試專論	3	3		
	基本電學實習	2	2				工程倫理			2	2
							工業安全與衛生			3	3
							工廠實務			3	3
							製造實務			3	3
							全面品質管理			3	3
	小計	7	7	8	8		現場作業實務			3	3
專 業 選 修					專 業 選 修	企業法規概念			3	3	
						小計	12	12	20	20	
						數位系統設計	3	3			
						積體電路設計概論	3	3			
					電磁學	3	3				

項目	學分	時數
校必修	18	20
院必修	12	12
專業必修	47	47
專業選修	3	3
合計	80	82

注意事項：

1. 畢業應修學分為80學分；含必修：77學分，選修：3學分(本系專業選修至少3學分以上)。

2. 表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。



電子工程系主任 楊信佳

半導體學院院長 呂明峰